

※板狀-內部氧化法 接點選用參考：

不同額定電流的開關，尺寸、材質的使用，因各種開關機構設計不同與接點材料的進步，很難訂出標準公式，此為多年試驗的經驗數據。

材 質	品元代號	特性比較(1 良 ~ 9 劣)		
		耐消耗	耐熔著	接觸電阻
AgCdO	D10	5	5	3
	D12	4-5	4-5	3-4
	D15	4	4	4
	X2	1-2	1-2	7-8
	X2G	1-2	1-2	7
	X3	1-2	1-2	7
	NP6	1-2	1-2	7
AgSnO ₂ In ₂ O ₃	F11	1-3	3	6
	F13	1-2	2	6-7

註：只限於本表內材質作比較，不與其他材質比較。

※板狀-內部氧化法 接點設計參考：

1. 常用尺寸公差：

- 1.1 板狀接點成型後，須進行氧化作業，尺寸會因此產生變化，除 t 厚之公差為±0.1mm，其它尺寸在 10mm 內者公差±0.1mm，超過 10mm 者公差為±0.2mm。
- 1.2 接點之長、寬或外徑最大不得超過 50mm，t 厚不得超過 3.0mm（不易氧化），最薄不得小於 0.7mm（依接點面積大小，面積越大銀厚亦須增加，面積越小銀厚則須減少），若厚度超過 3.0mm 或特殊形狀，建議使用粉末冶金法之板狀接點。
- 1.3 AgSnO₂In₂O₃ 內氧法板狀接點其材質易因氧化變形，尺寸宜在下列範圍：
 F 型：長、寬或外徑於 5mm 以下時，t 厚宜 0.9mm ~ 1.2mm；長寬或外徑超過 5mm 時，t 厚宜 1.2 ~ 3.0mm。
 R 型：長、寬或外徑於 10mm 以下時，t 厚宜 1.0 ~ 2.0mm；長寬或外徑

超過 10mm 時，t 厚宜 1.5 ~ 2.5mm。

總之，接點面積越大，t 厚須相對增加，太薄易變形。

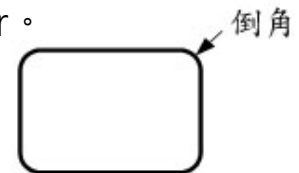
2. 弧面(R)：

2.1 弧面有：(A)長邊弧面(B)短邊弧面(C)球面弧面，因耐消耗材質較硬加工不易，建議少用球面弧面。

2.2 內氧法板狀弧面曲度易因加熱氧化產生變異，故公差較大，一般為 $\pm 10R$ 。

3. 倒角(r)：

內氧法板狀最好以自然倒角為宜，否則常採用倒角 0.3r。



4. 焊片(燒焊或背附)：

4.1 除無熔線斷路器(MCCB)因壽命試驗要求次數較少，背附用 BCuP-5 外，其餘開關建議使用 BAg-5、BAg-7 等不含 Cd 的 BAg 材質。

4.2 銀焊料的使用量依接點面積大小及焊接面的凹凸深淺而不同，背附焊片覆蓋面積須大於接點面積 50%以上，焊片厚度依材質特性而有所差異。

4.3 焊好的接點與銅座至少有 70%黏著，沿接點四周可看見熔融之焊片溢出（高度低於接點厚度的一半），且緊接接點四周圍繞為原則。

